

质疑答复函

质疑人：广西迈通信息技术有限责任公司

地址：南宁市青秀区东葛路 118 号青秀万达广场东 3 栋二十七层 2701 号房

邮编：530000

联系人：王昌杰 联系电话：13977368774

授权代表：王昌杰 联系电话：13977368774

地址：南宁市青秀区东葛路 118 号青秀万达广场东 3 栋二十七层 2701 号房

邮编：530000

质疑人现场递交的广西信息职业技术学院模型制作与渲染实训室设备采购（项目编号：GXZC2024-J1-003960-GXRY）的《质疑函》，我公司于 2024 年 06 月 20 日收悉，我公司将质疑函转达采购人，并经组织认真审查后，现对质疑事项答复如下：

质疑事项 1: 中标公告的序号 1 的 H3C Desk X700t G2 的货物名称不符合采购货物名称要求。

事实依据：根据招标公告及招标文件刊载，本次采购货物标第一项为“设计图形工作站”。根据公示中标品牌及型号为 H3C H3CDesk X700t G2, 根据新华三官网公示该型号为商用台式机，并非专业图形工作站。

官网链接如下：

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 1 答复：经与被质疑人核实货物名称只是名词代号，并不能代表中标产品的实际性能参数；H3C H3C DeskX700t G2 为设计图形工作站，各项指标均按工作站产品要求打造，产品本身符合工作站相关认证（见附件 1：厂商佐证材料）；质疑人提供官网资料截图不能代表中标产品的真实性能参数，官网资料是厂家对产品做出的最低性能描述，用于广告宣传不能全面的代表中标产品的实际性能参数，因此质疑人提出的质疑事项 1 不成立。

质疑事项 2: 中标人所投产品参数不满足招标文件中序号 1 “设计图形工作站” 中参数要求第二点要求“2. 芯片组：英特尔®W680 或以上”，根据新华三官网查询该型号主板为 Q670 主板，不符合参数要求：

事实依据：中标产品 H3C X700t-G2 属于商用 PC 机型号，不属于本次项目采购的工作站机型，主板为 Q670, 不满足参与要求。

官网链接如下：

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 2 答复：经与被质疑人核实，H3C X700t-G2 属于设计图形工作站，且在投标响应文件中被质疑人已实质的做出了响应 H3C X700t-G2 主板芯片为 Q670，并得到了谈判小组评委的认可；商用 PC 与工作站是生产厂家对产品做出的名称、代号。市场上各品牌厂家都有将主板芯

片 Q670 的设备命名为“工作站”如联想、惠普，资料如下：



Z1 G9 技术规格

品牌型号	HP Z1 G9 Tower Desktop PC
操作系统	Windows 11 家庭版 (可降级为WIN10家庭版)
处理器	可选支持:酷睿13代处理器 英特尔酷睿i5-13500处理器 14核20线程24MB缓存睿频频率4.80GHZ基础功耗65W容频功耗上限154W 英特尔酷睿17-13700处理器 16核24线程30MB缓存睿频频率5.20GHZ基础功耗65W容频功耗上限219W (数据来自英特尔, 还有其它支持型号未全部列出, 详细参数可与客服与厂商确认)
芯片组	英特尔Q670芯片组
内存	内存插槽数量: 4个DDR5 DIMM可支持内存: 128G 4800MHz DDR5; 出厂默认配置16G 4800MHz DDR5
硬盘	1个2.5 英寸 HDD 2个3.5 英寸 HDD 2个 M.2 NVME 2280 SSD PCIe 4.0 默认配置: 1块SSD 512GB M.2 NVME (可按需配置大容量) 提示: 增加机械硬盘需要专用螺丝及SATA线。
Raid	集成 SATA 6.0 Gb/s 控制器; 集成带有 RAID 功能的控制器, 主板集成RAID 0.1.5
显卡	按需配置独显, 可支持280MM长以内的显卡, 可以支持RTX4070显卡
音频	集成声卡Realtek ALC3252 2W单声道放大器仅用于内置扬声器
网络	集成英特尔千兆以太网控制器
端口	机箱前面: (4) 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 端口, 10 Gbps 信号传输速率 (1) 个 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 端口, 20 Gbps 信号传输速率 (1) 个通用音频插孔, 支持 CTIA 耳机; (1) 个超薄光驱DVD RW (ODD 或可移动存储) 机箱后面: (3) 个 USB 2.0 Type-A 端口, 480 Mbps 信号传输速率 (3) 个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 端口, 5 Gbps 信号传输速率 (2) 个 DisplayPort 1.4a 端口 (1) 个 HDMI 1.4 端口

根据竞争性文件第三章项目采购需求和说明“5、竞争性谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款, 必须满足或优于, 否则竞标无效; 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达4项(不含)以上的竞标无效。”规定, 被质疑人在投标响应 H3C X700t-G2 主板芯片为 Q670, 为投标响应的第1项负偏离, 满足竞争性文件要求。因此质疑人提出的质疑事项2不成立。

质疑事项3: 中标人所投产品第1项“设计图形工作站”中参数要求第四点要求“▲4. 硬盘: $\geq 512\text{GB}$ PCIe NVMe Class 40 M.2 TBW $\geq 80\text{TB}$ 固态硬盘 + $\geq 1\text{TB}$ 7200rpm SATA 3.5 英寸硬盘、通电时间 ≥ 5 万小时, 响应时间 $\leq 30\text{s}$ 工作状态环境温度应满足 $5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$, 支持 ≥ 3 个 M.2. 2280 PCIe NVMe SSD, 不占用原有 PCIE 插槽, 支持 ≥ 4 个 2.5 英寸或者 ≥ 3 个 3.5 英寸及以上的接入, 支持前置面板硬盘热插拔;”, 根据新华三挂网查询该机型, 硬盘参数部分不满足通电时间 ≥ 5 万小时, 响应时间 $\leq 30\text{s}$ 工作状态环境温度应满足 $5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 要求, 也不支持 ≥ 4 个 2.5 英寸或者 ≥ 3 个 3.5 英寸及以上的接入及前置面板硬盘热插拔;

事实依据: 中标产品 H3C X700t-G2 属于商用 PC 机型号, 最高支持 3*PCIe 4.0 NMe SSD; 或 3 * 2TB SSD+2*2TB HDD 组合, 最大支持 2 个 3.5 英寸 7200 转机械硬盘, 标配支持单盘最大容量 2TB, 机箱前置面板无硬盘热插拔插槽不满足参与要求, 且该项目为废标项。

官网链接如下：

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 3 答复：经与被质疑人核实，H3C X700t-G2 属于设计图形工作站，满足▲4. 硬盘：≥512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 TBW≥80TB 固态硬盘+≥1TB 7200rpm SATA 3.5 英寸硬盘、通电时间≥5 万小时，响应时间≤30s 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，支持≥ 3 个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，不占用原有 PCIe 插槽，支持≥4 个 2.5 英寸或者≥3 个 3.5 英寸及以上的接入，支持前置面板硬盘热插拔，产品符合招标文件要求（见附件 1：厂商佐证材料）；厂家官网参数只做为产品的传宣，不能作为投标实际性能参数，因此质疑人提出的质疑事项 3 不成立。

质疑事项 4：中标人所投产品不满足招标文件参数第 1 项“设计图形工作站”中参数要求第七点要求“7. 主板规格：

a) 端口：正面：≥4 个 USB 3.2 端口，≥1 个麦克风/耳机 2 合 1 端口；内置：1 个 USB 3.0 端口，≥4 个 SATA 6 Gb/s 端口；背面：≥2 个 DisplayPort 1.4 端口、≥2 个 USB 2.0 (480 MB) 端口，支持智能开机、≥2 个 USB3.2Gen2(10GB)端口、≥2 个 USB3.2Type-CGen2(10GB)端口、RJ45 以太网端口，1 Ghz；音频输出：可选端口(VGA、HDMI 2.0、DP++1.4、Type C,支持 DP 替代模式)”，根据新华三官网查询 H3CX700t-G2 机型参数，中标型号不满足要求参数要求；

事实依据：H3C X700t-G2 机型官网描述规格参数“内部扩展和可选功能扩展及整个产品参数描述中均未发现可以支持内置 1 个 USB3.0 端口，后置接口及整个产品参数描述中也未支持≥2 个 DisplayPort 1.4 端口、≥2 个 USB3.2Gen2(10GB)端口、≥2 个 USB3.2Type-CGen2(10GB)端口；存在虚假应标。

官网链接如下：

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 4 答复：经与被质疑人核实，H3C X700t-G2 设计图形工作站是厂家最新发布的产品，由于涉及商业机密，厂家对产品技术参数宣传时有所保留，只做了产品最低性能参数的宣传，因此官网描述规格参数不能全面的代表投标产品实际参数。H3C X700t-G2 设计图形工作站满足 a) 端口：正面：≥4 个 USB 3.2 端口，≥1 个麦克风/耳机 2 合 1 端口；内置：1 个 USB 3.0 端口，≥4 个 SATA 6 Gb/s 端口；背面：≥2 个 DisplayPort 1.4 端口、≥2 个 USB 2.0 (480 MB)端口，支持智能开机、≥2 个 USB3.2Gen2(10GB)端口、≥2 个 USB3.2Type-CGen2(10GB)端口、RJ45 以太网端口，1 Ghz；音频输出：可选端口(VGA、HDMI 2.0、DP++ 1.4、Type C，支持 DP 替代模式)；满足招标参数要求（见附件 1：厂商佐证材料）；因此质疑人提出的质疑事项 4 不成立。

质疑事项 5：中标人所投产品参数不满足序号 1“设计图形工作站”中参数要求第七点要求“7. 主板规格：b) 插槽：全高 Gen5 PCIe x16. 插槽、全高 Gen3PCIe x4 插槽、全高 Gen4PCIex4 插槽、≥1 个用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2230 插槽、≥2 个适用于 NVMe SSD 的 M.2.2230/2280 PCIe Gen4 插槽、≥1 个适用于 NVMe SSD. 的 M.22280 PCIe Gen3 插槽、≥5 个适用于 2.5/3.5 英寸

HDD/ODD 的 SATA 插槽, 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 $\geq 32\text{GB}$; ”

事实依据: 本次中标机型为 H3C X700t-G2, 所配置主板为英特尔 Q670 芯片组, 插槽最高支持 PCIe 4.0 x16, 没有办法支持 Gen5 PCIe x16. 插槽. 而且产品描述只支持 4 个 SATA 插槽, 存在虚假应标。

官网链接如下:

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 5 答复: 经与被质疑人确认, 中标产品 H3C X700t-G2, 支持 7. 主板规格:b) 插槽: 全高 Gen5 PCIe x16. 插槽、全高 Gen3 PCIe x4 插槽、全高 Gen4 PCIe x4 插槽、 ≥ 1 个用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽、 ≥ 2 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 插槽、 ≥ 1 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽、 ≥ 5 个适用于 2.5/3.5 英寸 HDD/ODD 的 SATA 插槽, 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 $\geq 32\text{GB}$; 满足参数要求 (见附件 1: 厂商佐证材料); 因此质疑人提出的质疑事项 5 不成立。

质疑事项 6: 中标人所投产品参数不满足招标文件序号 1 “设计图形工作站” 中参数要求第十五点要求 “15. 机箱规格: 高 X 宽 X 深: ≥ 36.9 厘米 $\times 17.3$ 厘米 $\times 42$ 厘米;

事实依据: 本次中标机型为 H3C X700t-G2, 机箱尺寸为 163mm(宽) $\times 310\text{mm}$ (纵深) $\times 403\text{mm}$ (高), 明显不符合要求。

官网链接如下:

<https://www.h3c.com/cn/ProductsAndSolution/CommercialClientsProduct/CommercialDesktops/X700t-G2/>

质疑事项 6 答复: 被质疑人在投标响应文件中已实质的做出了响应 H3C X700t-G2 机箱规格: 高 $\times$ 宽 $\times$ 深: 40.3 厘米 $\times 16.3$ 厘米 $\times 31$ 厘米, 并得到了谈判小组评委的认可, 根据竞争性文件第三章项目采购需求和说明 “5、竞争性谈判文件中标注 “▲” 号的条款为实质性条款, 必须满足或优于, 否则竞标无效; 非 “▲” 号要求或技术指标发生负偏离或不响应达 4 项 (不含) 以上的竞标无效。” 被质疑人在投标响应 H3C X700t-G2 机箱规格: 高 $\times$ 宽 $\times$ 深: 40.3 厘米 $\times 16.3$ 厘米 $\times 31$ 厘米, 为投标响应的第 2 项负偏离, 满足竞争性文件要求 (见附件 1: 厂商佐证材料); 因此质疑人提出的质疑事项 6 不成立。

质疑事项 7: 中标人所投产品参数不满足招标文件序号 9 “智慧纳米黑板” 中参数第二十二点要求 “22. 前置隐藏式接口 (双通道 USB3.0 $\times 3$, 触摸 USB $\times 1$, HDMI $\times 1$, Type-C $\times 1$);

事实依据: 本次中标机型为鸿合 HB-H831D, 通过该产品的宣传彩页及检测报告查询均发现中标产品接口参数不符合招标参数要求。

质疑事项 7 答复: 经与被质疑人核实, 本次中标产品为 2024 款鸿合 HB-H831D 是厂家的最新款智慧纳米黑板, 支持前置隐藏式接口 (双通道 USB3.0 $\times 3$, 触摸 USB $\times 1$, HDMI $\times 1$, Type-C $\times 1$) (见附件 2: 厂商佐证材料)。质疑人采用 2023 年的资料与检测报告做为质疑证据, 不能证明中标产品的实际性能参数, 因此质疑人提出的质疑事项不成立。

综上所述，质疑人质疑事项不成立。

质疑人如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定，可在质疑答复期满后十五个工作日内向本项目政府采购监督管理部门投诉，特此答复。

广西睿翼工程咨询有限公司

2024年07月01日





工作站参数证明

广西信息职业技术学院、广西睿翼工程咨询有限公司：

针对贵单位组织的广西信息职业技术学院模型制作与渲染实训室设备采购项目(项目编号：GXZC2024-J1-003960-GXRY)采购设备：设计图形工作站，对于被质疑部分，我司提供的产品技术参数满足如下情况：

H3C\H3CDesk X700t G2\新华三技术有限公司\中国

1、所投产品为：新华三设计图形工作站；

2、产品芯片组：英特尔® Q670；

3、硬盘满足：≥512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 TBW≥80TB 固态硬盘+≥1TB 7200rpm SATA 3.5英寸硬盘、通电时间≥5万小时，响应时间≤30s 工作状态环境温度应满足5℃~55℃，支持≥ 3个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，不占用原有 PCIe插槽，支持≥4个2.5 英寸或者≥3个3.5英寸及以上的接入，支持前置面板硬盘热插拔；

4、主板规格满足： a) 端口：正面：≥4个 USB 3.2 端口，≥1个麦克风/耳机2 合1端口；内置：1个USB 3.0端口，≥4个SATA 6 Gb/s端口；背面：≥2个DisplayPort 1.4 端口、≥2个USB 2.0 (480 MB)端口，支持智能开机、≥2个USB3.2Gen2(10GB) 端口、≥2个USB3.2Type-CGen2(10GB)端口、RJ45以太网端口，1 Ghz；音频输出：可选端口(VGA、HDMI 2.0、 DP++ 1.4、 Type C，支持DP替代模式)； b) 插槽：全高Gen5 PCIe x16 插槽、全高Gen3 PCIe x4插槽、全高Gen4PClex4插槽、 ≥1个用于WiFi和蓝牙卡的M.2 2230 插槽、≥2个适用于NVMe SSD的M.2 2230/2280 PCIe Gen4插槽、≥1个适用于 NVMe SSD.的M.2 2280 PCIe Gen3插槽、≥5个适用于2.5/3.5 英寸HDD/ODD 的SATA插槽，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB；

5、主板规格满足： b) 插槽：全高Gen5 PCIe x16 插槽、全高Gen3 PCIe x4插槽、全高Gen4PClex4插槽、≥1个用于WiFi和蓝牙卡的M.2 2230 插槽、≥2个适用于NVMe SSD的M.2 2230/2280 PCIe Gen4插槽、≥1个适用于 NVMe SSD.的M.2 2280 PCIe Gen3插槽、≥5个适用于2.5/3.5 英寸HDD/ODD 的SATA插槽，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB；

6、机箱规格如下：高 × 宽 × 深：40.3厘米 × 16.3厘米 × 31厘米； a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 在产品显著位置提供运行状态指示功能；

综上，我公司生产的商用设计图形工作站存在负偏离情况，但符合项目招标要求。

感谢贵单位对新华三商用终端产品的支持，谢谢！



制造商参数证明函

广西信息职业技术学院、广西睿翼工程咨询有限公司：

针对贵单位组织的广西信息职业技术学院模型制作与渲染实训室设备采购项目(项目编号：GXZC2024-J1-003960-GXRY)采购设备，对于被质疑技术参数，我司提供的产品技术参数如下：

本项目中标产品是我司新款产品，经我司技术工程师核对符合本项目采购要求。

品牌型号	技术参数
鸿合 H1B-H831D	支持前置隐藏式接口(双通道 USB3.0x3, 触摸 USBx1, HDMIx1, Type-Cx1)

制造商：深圳市鸿合创新信息技术有限公司

日期：2024.6.24